

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025022

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本 1,052,193,000 股扣除回购专户中已回购股份 22,589,592 股后的股本总额 1,029,603,408 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大族激光	股票代码	002008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜永刚	王琳	
办公地址	广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心	广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心	
传真	0755-86161327	0755-86161327	
电话	0755-86161340	0755-86161340	
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、主要业务、主要产品及其用途

公司是一家专业从事智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商。

公司主要产品分为：通用元件及行业普及产品、行业专机产品、极限制造产品三大类。

（1）通用元件及行业普及产品

通用元件及行业普及产品为紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率 CO₂ 激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等工业激光加工设备及自动化设备的关键器件。

报告期内，公司通用元件及行业普及产品主要为集成在整机设备上一并销售，直接对外销售的规模较小。

（2）行业专机产品

行业专机产品为信息产业设备、新能源设备、半导体设备等行业专用设备。该类产品行业特性强，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，受下游客户所处行业影响较大。

1) 信息产业设备

消费电子设备：主要产品为专用激光打标设备、激光焊接设备、激光钻孔设备、防水气密性检测设备、CNC 数控机床等，用于手机、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品的生产加工环节。

PCB 设备：主要产品为钻孔设备、激光直接成像设备、成型设备以及检测设备等，面向钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 生产的关键工序。

2) 新能源设备

锂电设备：主要产品为匀浆、搅拌、涂布、辊压、模切、分切、卷绕/叠片、电芯组装、烘烤、注液、化成分容等加工设备及自动化生产线，用于锂电池电芯、模组、PACK 段的生产加工环节。

光伏设备：主要产品在光伏电池及组件环节，包括 TOPCon 电池生产主设备：激光硼掺杂设备、PECVD（等离子增强气相沉积设备）、LPCVD（低压化学气相沉积设备）、扩散炉、氧化炉、退火炉，以及组件段的无损划片机、划焊一体机等。

3) 半导体设备

主要产品为激光表切、全切设备，激光内部改质切割设备等前道晶圆切割设备，及焊线设备、固晶设备、测试编带设备等后道封测设备及晶圆自动化传输设备，用于半导体及 LED、显示面板等泛半导体的生产加工环节。

（3）极限制造产品

极限制造产品为标准激光切割、焊接、打标设备等通用激光加工设备。通用激光加工设备主要应用于金属及非金属材料的工业加工环节，凭借速度快、精度高、加工质量好等优势，逐步替代传统机械加工设备，大幅提高了工业加工效率和品质。该业务的下游相对广泛且分散，应用于工程机械、建设机械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等多个行业。

现阶段，行业专机和极限制造产品仍是公司主要的收入与利润来源。公司研发生产的紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率 CO₂ 激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等通用元件及行业普及产品已全面推向市场，有望成为公司新的业绩驱动因素。

2、经营模式

（1）生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，具体为：供应链与交付平台结合需求预测、意向订单、实际订单、备货情况及产能等情况，按月编制《整机计划》，按 BOM 组织物料，由生产部门按作业指导书进行模块化组装，再进行总装调试。公司制定了《生产运行控制程序》、《生产及物料计划管理规定》、《产品测量与监控程序》等制度，从来料、半成品、装配过程、成品入库、出货等多方面对产品进行质量检测及品质把控。

（2）采购模式

公司主要采用“以产定采”辅以“安全库存”的方式开展生产性物料的采购，主要采购类别包括钣金机加件、机械器件、外购模组、光学器件等。公司按照供应商管理办法，根据物料特性开发供应商，通过审厂、样品测试等方式对供应商资质进行审核，被纳入合格供应商名录的企业还需接受定期考核及复审。公司采用询价采购或年度框架协议等模式，按照原材料性质，从合格供应商库中选择合适供应商进行采购。对于标准部件，公司主要结合原材料的质量、价格、交期等因素进行采购；对于非标准化部件，公司会对部件进行自主设计后，根据供应商的技术水平、加工能力和报价等因素择优确定。

公司根据各类物料的采购周期以及《整机计划》进行原材料备货，对于核心物料、贵重物料每个月根据市场发机计划安排提货；对于辅料类按照安全库存模式进行备货。公司与供应商在采购合同中会约定不同的信用政策，并主要通过银行转账、承兑汇票等方式与供应商结算。

（3）销售模式

公司在国内市场主要采取直销模式，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，公司根据产品的应用领域和市场特点，借助产品和技术优势不断拓展国内外行业知名客户资源，深入挖掘客户需求，获取市场业务机会，将公司生产的各类智能制造装备，以直销方式销售给国内客户。境外销售采用直销模式和代理销售模式。直销模式方面，公司与境外客户签订合同，由公司进行报关发货后交付至客户；代理销售模式方面，公司采用代理商销售模式和贸易商销售模式开拓境外业务。由于部分代理商和贸易商具有丰富的客户资源，公司为提升与该等客户的合作深度，争取更多的市场份额，与代理商和贸易商建立了长期合作关系。代理商与公司签订长期代理协议，向公司提供市场和客户信息，推荐意向客户，公司与客户商谈后签署销售合同。贸易商与公司签订采购合同，向公司采购产品后通过自有销售渠道将产品销售给其客户。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

公司经过了二十多年的发展和技术积累，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。

2024 年年度营业收入 1,477,121.54 万元，营业利润 181,577.09 万元，归属于母公司的净利润 169,390.03 万元，扣除非经常性损益后净利润 44,463.40 万元，分别较上年同期增减 4.83%、120.61%、106.52%、-4.39%。

报告期内，公司主要收入来自于行业专机产品及极限制造产品，具体情况如下：

（1）信息产业设备业务逐步走过去库存周期，行业有望迎来复苏

报告期内，公司信息产业设备业务实现收入 54.86 亿元，同比增长 43.73%。其中，消费电子设备业务实现营业收入 21.43 亿元，同比基本持平。公司围绕大客户的创新性需求，密切参与其各类消费电子产品的生产研发环节，在激光加工、3D 打印、自动化、密封检测等环节持续更新产品和工艺，积极配合客户进行设备迭代升级。AI 技术正在引领消费电子行业的创新周期，公司抓住市场动态与机遇，紧跟客户变化，基于客户的定制化需求，提供了激光钎焊机、激光镭雕机、激光 3D 打印机、自动化组装设备等产品，亦为客户打造了多台实验室定制设备，应用于前沿技术和高端制造领域。随着 AIPC、AI 手机等 AI 终端产品的推出，力求进一步提升公司在消费电子行业的市场占有率。当前，消费电子供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚等地设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已组建海外生产、研发、销售团队，力争抓住供应链多元化带来的市场机会。

PCB 设备业务实现营业收入 33.43 亿元，较去年大幅增长 104.56%。AI 产业链服务器、高速交换机等基础设施需求爆发，叠加消费电子市场复苏，PCB 专用加工设备市场需求快速反弹。公司针对不同细分市场需求开发创新产品，并实施专业化的整体解决方案布局，从 PCB 产品功能最优品质及成本效益出发，突破传统工艺技术瓶颈，提升产能和产品品质，赋能 PCB 产业快速增长及技术升级，各类产品营收取得较大幅度增长。

在普通多层板及 HDI 板市场，公司不断推出新场景下的创新工艺解决方案，加上新布局工序产品日渐成熟，市场竞争地位愈发巩固；在受益于 AI 服务器爆发、快速增长的高多层板及高多层 HDI 板市场，公司积极提升产品技术能力，与下游客户技术需求契合度较高，整体市场地位得到快速提升；在更高技术需求的类载板、IC 封装基板及先进封装领域，公司在行业内率先推出各类新型激光解决方案，获得众多行业头部客户的工艺及品质认证，并形成正式订单及意向需求。

（2）新能源设备业务销售额下降，持续发力海外业务

报告期内，公司新能源设备业务实现收入 15.40 亿元，同比下降 40.48%。国内各家动力电池及光伏厂商扩产步伐均不同程度放缓，新能源设备业务整体销售额下降。锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司持续推进与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能、蜂巢能源等行业主流客户的合作，积极参与到大客户出海的进程中，抓住新能源市场发展的全球化发展机遇，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续提升盈利能力。

光伏设备方面，受行业景气度影响，下游客户资本开支明显减少，对公司相关设备订单造成一定影响。公司在主流电池厂家取得主制程设备（PECVD、LPCVD、硼扩散炉、退火炉等）批量订单，并与主流客户共同开发验证电池生产工序核心装备。同时，公司加快海外业务的拓展步伐，中标客户在老挝等地订单。在钙钛矿技术领域，公司持续优化钙钛矿激光刻划相关设备工艺及性能，在该细分领域市场占有率处于领先地位，与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作关系。

（3）半导体设备业务较为平稳，持续推进新产品研发验证

报告期内，半导体设备（含泛半导体）业务实现营业收入 17.75 亿元，同比下降 16.55%。半导体产业方面，SiC 晶锭激光剥片研磨一体机、激光解键合设备、去胶显影机、去胶剥离机等多种量产设备取得业内大客户正式订单。公司持续加大研发投入，完成 DDS 冷扩机、SDTT 透膜隐切机等多种设备的研发工作，并成功实现第四代半导体金刚石激光有效剥片，填补了国内在该领域的技术空白。以显示面板为代表的泛半导体行业景气度持续回升，下游客户新项目陆续开始招投标工作，相关订单相较去年有所增长。公司推进激光切割、钻孔，激光修复，激光剥离等设备的技术升级和性能改善，成功研发、生产多款显示行业国内首台设备，打破面板前段及中段工艺进口设备的垄断，取得国内首台前段核心制程设备订单，单台设备金额超过 5,000 万元，激光修复机、平板显示器基板切割机多次中标京东方 AMOLED（柔性）生产线项目，获得行业龙头客户的广泛认可。

（4）通用工业激光加工设备市场需求稳中向好，盈利持续改善

报告期内，通用工业激光加工设备业务实现营业收入 59.71 亿元，同比增长 7.64%。其中，高功率激光切割设备实现营业收入 29.63 亿元，同比增长 26.67%；高功率激光焊接设备业务实现营业收入 4.24 亿元，同比下降 31.01%。激光切割行业竞争激烈，市场格局日新月异。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品；坚持爆品打造，实现产品的大规模市场推广与销售放量；同时，严格坚守质量底线，坚持以质量为本。公司自主研发的三维五轴切割头取得突破，首年销售额突破 5,000 万，实现了广泛的国产替代，普遍应用于汽车行业热成型加工领域。公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大公司在高端领域的市场影响力。与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作，在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得进步。另一方面，根据市场需求，加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，盈利能力明显改善。小功率激光设备方面，2024 年公司在精密切割、特种焊接、玻璃切割等领域的设备销售额取得大幅增长，在紫外及超快激光器、脉冲光纤激光器、中低功率激光焊接、掺镱固体激光器、CO₂ 激光器等产品领域均取得技术突破并获广泛认可。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	34,227,059,742.80	34,200,363,737.11	0.08%	32,048,809,589.75
归属于上市公司股东的净资产	16,138,927,404.74	15,000,349,121.49	7.59%	14,200,223,701.17
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	14,771,215,354.04	14,091,101,814.42	4.83%	14,961,185,040.35
归属于上市公司股东的净利润	1,693,900,253.05	820,218,770.84	106.52%	1,214,512,137.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,633,990.18	465,048,324.52	-4.39%	978,458,839.00
经营活动产生的现金流量净额	1,126,050,737.62	1,362,628,841.47	-17.36%	650,323,866.86
基本每股收益（元/股）	1.62	0.78	107.69%	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.62	0.78	107.69%	1.15
加权平均净资产收益率	10.95%	5.61%	5.34%	8.90%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,655,635,712.91	3,699,574,239.18	3,773,743,855.31	4,642,261,546.64
归属于上市公司股东的净利润	988,980,528.81	235,931,507.95	201,178,112.47	267,810,103.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,580,825.55	225,994,344.75	154,852,409.77	69,368,061.21
经营活动产生的现金流量净额	-310,337,654.94	112,387,519.02	283,205,941.72	1,040,794,931.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	186,486	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	157,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.37%	161,773,306	0	质押	110,870,000	
高云峰	境外自然人	9.15%	96,319,535	72,239,651	质押	87,590,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	23,349,260	0	不适用	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	20,270,407	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	11,784,486	0	不适用	0	
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.66%	6,956,400	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	6,203,332	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	2,128,600	0	不适用	0	
王斌	境内自然人	0.16%	1,671,128	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	1,615,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			大族控股集团有限公司之控股股东系高云峰，高云峰与大族控股集团有限公司系一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	968,332	0.09%	114,600	0.01%	6,203,332	0.59%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,642,872	0.44%	1,363,300	0.13%	11,784,486	1.12%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

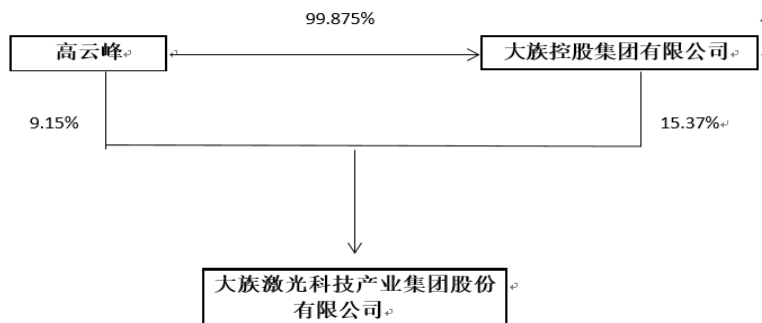
☐适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，公司终止分拆子公司深圳市大族封测股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市并撤回上市相关申请文件，具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2024012）。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 22 日

